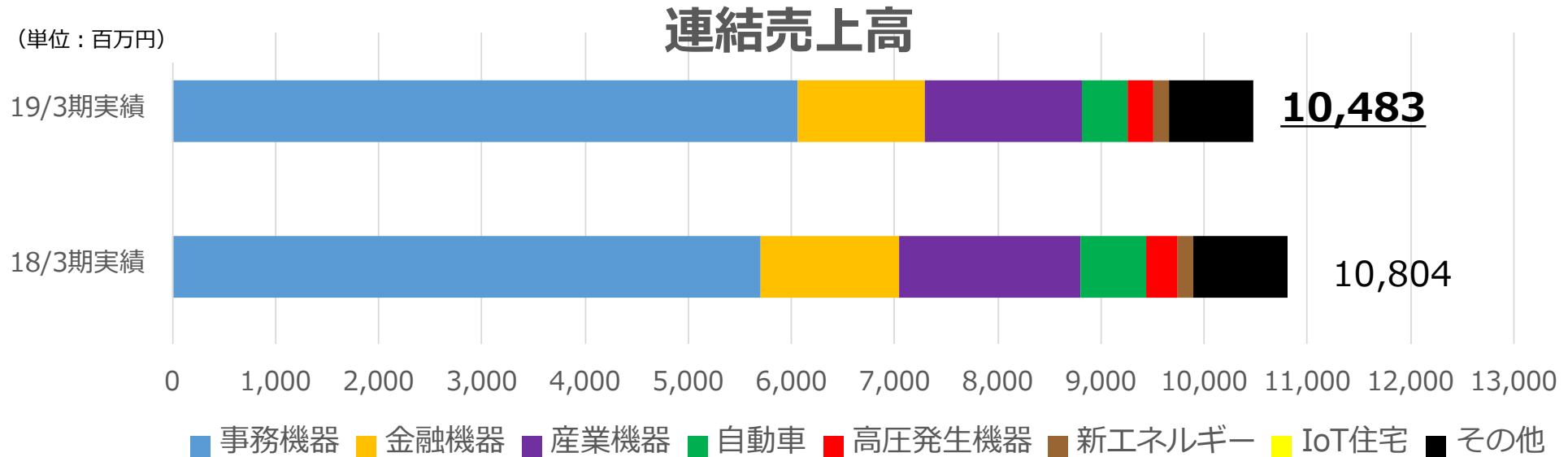


コンポーネント事業 実績



19/3期概況

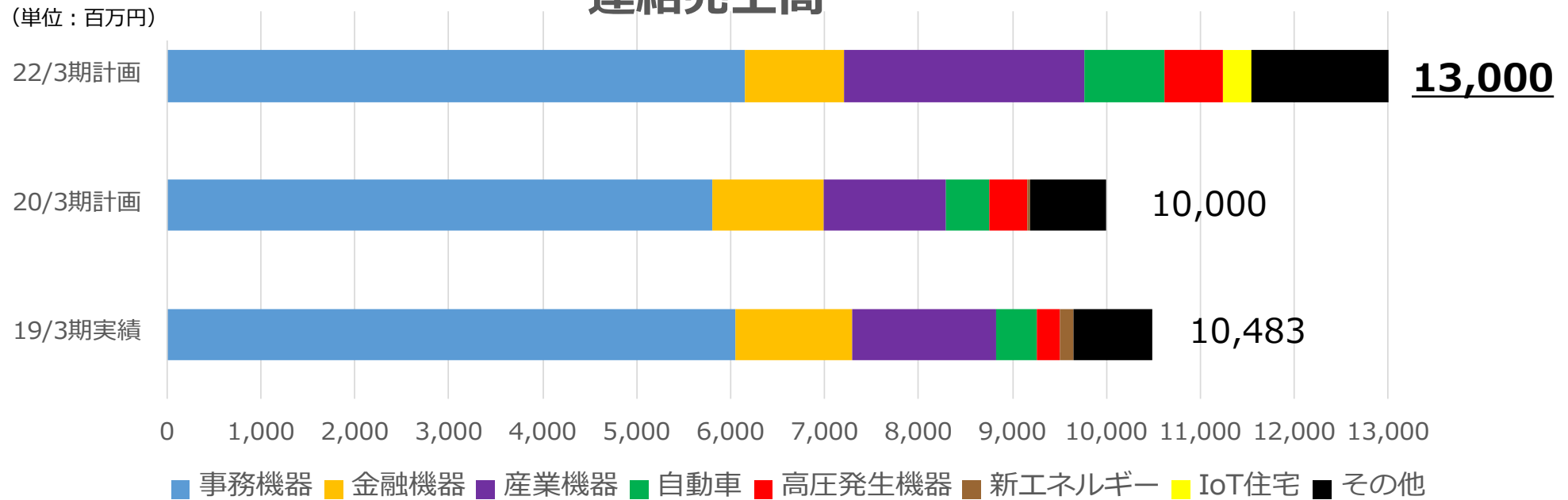
- 前期比3%減
- 主力の事務機器向け販売増
- 産業機器、自動車向け販売減

前中計課題

- 大量生産体制及び外部生産体制の合理化
- 産業機器市場の減速に対する対策取組み
- 新製品開発及び新市場開拓

コンポーネント事業 計画

連結売上高



新中計戦略

- 新市場開拓
- 製品群の拡充（シリーズ化）
- マーケティング強化と新製品開発
- ASEAN市場での安定供給体制構築
- 技術の融合による半導体事業の発展

注力市場

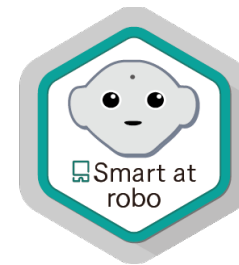
- 自動車、ロボット、住宅設備、医療機器

戦略製品

- 小型高トルクリミッタ（精密機構部品）
- 防塵・防水環境用軸受（精密機構部品）
- 多ピンモジュールとSiC化（半導体デバイス）

1) 新市場開拓

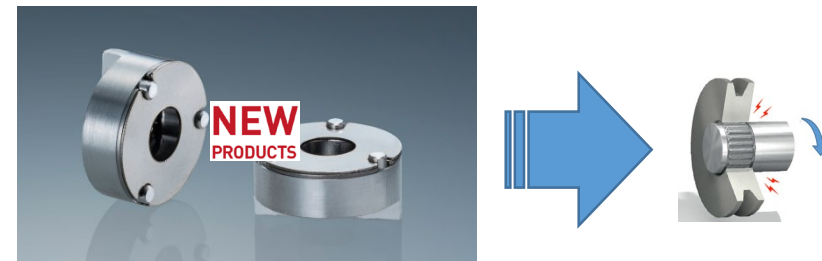
- 自動車市場
- ロボット市場
- 住宅設備市場



2) 製品群の拡充 (シリーズ化)

- 安全機構用トルクリミッタ 短期テーマ
- 防塵・防水環境用軸受 中期テーマ
- 電動アクチュエータ ※1 長期テーマ

※1 : 電動アクチュエータ
電動駆動製品
(例: モーター + 弊社製品)



新製品 : 小型高トルクリミッタ

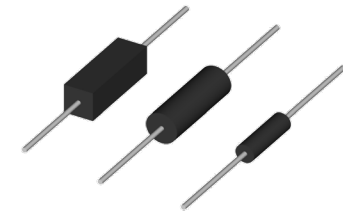
3) マーケティング強化と新製品開発

- ・フルSiCモジュール
- ・ドライブ回路搭載モジュール



次世代化合物等を搭載し、更に顧客からの要望が増えてきている駆動回路搭載など、複合化モジュールの市場投入・品種展開を進める（ダイオード単品からカスタムモジュール化）

- ・高圧ダイオード（15kV品）



医療機器向けに8kV製品に加え新たに15kV製品を投入し、日本国内及び、中国・欧州への拡販を行う